

基于 AlN 轮廓模式矩形盘谐振器的研究

郑升灵, 李丽, 要志宏, 李宏军, 李丰

(中国电子科技集团公司第十三研究所 十六专业部, 河北 石家庄 050051)

摘要:介绍了微型化体声波谐振器的理论模型和实作结果,采用微电子和微机械加工技术,实现了一种上、下电极覆盖压电 AlN 的“三明治”空气腔悬梁结构。该谐振器具有微型化,高品质因数,低成本的特点,实作的谐振器频率约 20 MHz,品质因数为 800,机电耦合系数约 0.5%。

关键词:氮化铝(AlN);轮廓模式;体声波;矩形盘谐振器

中图分类号:TN75 文献标识码:A

Study on the Resonator of AlN Contour-mode Rectangle Plate

ZHENG Shengling, LI Li, YAO Zhihong, LI Hongjun, LI Feng

(The Sixteen Dept., 13th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Shijiazhuang 050051, China)

Abstract: This paper reports on theory modeling and experimental verification of a miniature resonator of bulk acoustic wave. An AlN sandwiched air-cavity cantilever structure between a bottom electrode and a top electrode is fabricated by using the microelectronic and micromechanical technology. The resonator has the features of miniature, high Q and low cost. The resonant frequency of the fabricated resonator is 20 MHz, Q is about 800 and the electro-mechanical coupling coefficient is about 0.5%.

Key words: aluminum nitride(AlN); contour-mode; bulk acoustic wave; rectangle plate resonator

0 引言

随着无线通信的发展,有限的信道资源日益拥挤,高性能的窄带器件成为关键,而谐振器起着决定作用。一直以来,陶瓷谐振器由于易加工及温度稳定性高,从而占据着射频领域大部分市场;随着小型化、低成本化的需求,声表面波谐振器和 Avago 公司的声体波(FBAR)谐振器^[1]的广泛应用为无线通讯带来了新的革命。但近几年,随着微电子的发展和微机械的工艺技术逐渐趋于成熟,一种基于该技术应运而生的微型、低成本、高品质因数 Q 值的轮廓模式压电谐振器成为研究的热点。它具有陶瓷、声表谐振器无可比拟的优点:工作频率范围更宽,更高的 Q 值,体积更小,更重要的是可与 IC 等工艺兼容,实现与其他器件一体化集成。

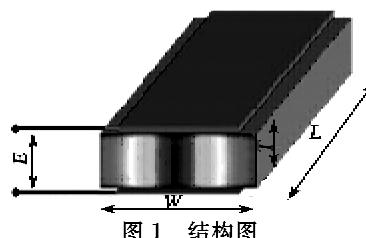
本文介绍了基于轮廓模式谐振的一种典型结构原理和 Butterworth Van-Dyke(BVD)^[2]分析方法,利用射频反应溅射法进行了高质量的压电薄膜制备,采用表面硅工艺成功制作出约 20 MHz 的矩形

盘谐振器,并计算分析了谐振器的重要表征参数机电耦合系数(k_t)和 Q 值。

1 谐振器模型

1.1 工作原理

该微型谐振器主要由输入、输出电极和中间夹持压电薄膜组成的“三明治”结构,如图 1 所示, L 为长度, W 为宽度, T 为厚度^[3]。



当通过在上、下电极厚度(T)方向外加一电场 E 时,弹性电介质内部正负电荷的中心相对位移而进行极化,通过压电耦合系数 d_{31} 转换产生横向的质子运动,从而引起形变形成轮廓伸缩模式的振动,此模式的谐振器称盘状模式谐振器。这种矩形盘状伸

收稿日期:2013-03-28

作者简介:郑升灵(1976-),男,江西人,高级工程师,主要从事微型单片压电体声波的谐振、滤波等技术研发与制作研究。

缩振动主要激励起两种模式,即长度伸缩和宽度伸缩振动,两种谐振模式同时存在,如图 2 所示。

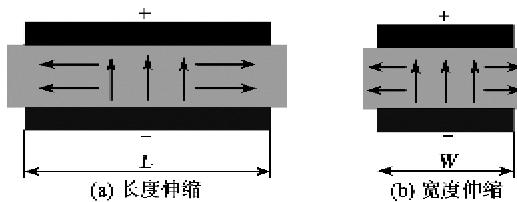


图 2 原理图

长度伸缩的振动谐振频率^[4]为

$$f_0 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{E_{eq}}{\rho_{eq}}} \quad (1)$$

式中: E_{eq} 为等效弹性模量; ρ_{eq} 为等效体密度。式(1)表明谐振频率主要取决于 L 、 E_{eq} 、 ρ_{eq} ,而与薄膜的厚度无关。宽度伸缩振动即把式(1)中长度 L 换成宽度 W ,就可得到宽度振动频率。

若要获得较低的谐振频率,通过增大 L 或 W 可得,特别是单一芯片上可设计多个不同的 L 或 W ,实现了频率的多样性,而类似的 FBAR 谐振器主要由压电薄膜的厚度决定器件的频率,相对单一。更重要的是通过电极尺寸的特殊设计,可获得高次泛音的谐振,频率可达 10 GHz,覆盖了 FBAR 常规的设计频段,所以从适用频率范围、成本、灵活性来说,压电轮廓模式谐振器将会成为最有发展的谐振器技术,它的相关应用会越来越广泛。

1.2 谐振分析

体声波谐振器的分析方法有 Mason 模型、Modified Butterworth Van-Dyke(MBVD)模型及有限元压电分析等。下面介绍一种简单、最常用的谐振点附近近似等效电路的 Butterworth Van-Dyke(BVD)模型来分析“三明治”结构的谐振特性,是 MBVD 的简化模型,它完整解释了压电动生参数,具有实际意义,如图 3 所示。图中, C_0 为静态电容, C_m 、 L_m 、 R_m 分别为与机械振动相关的动态电容、电感和损耗^[2,5]。

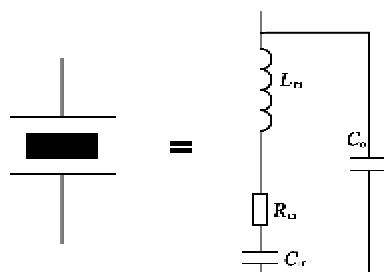


图 3 BVD 等效电路

矩形盘状结构,长度伸缩模式下 BVD 表达式为

$$C_0 = (\epsilon_s^s A) / T \quad (2)$$

$$C_m = \frac{8}{\pi^2} k_t^2 C_c \quad (3)$$

$$L_m = \frac{L^2}{8C_0 k_t^2 E_{eq}} \quad (4)$$

$$R_m = \frac{\pi L}{8C_0 k_t^2 Q_s} \sqrt{\frac{\rho_{eq}}{E_{eq}}} \quad (5)$$

式中: ϵ_s^s 为夹持介电常数; A 为夹持面积; Q_s 为串联谐振品质因数。

给定谐振器的物理尺寸,能得出对应的 C_0 ,而 C_m 、 L_m 、 R_m 主要与 k_t^2 、 E_{eq} 、 ρ_{eq} 等相关,这些参数的大小取决于压电和电极材料的特性。特别是 k_t^2 和 Q 与压电薄膜的质量密切相关,要想得到低的 R_m ,必须获得高 Q_s 、大的 k_t^2 ,则需要高 C 轴的 002 择优取向的薄膜。表征 C 轴取向的重要参数之一是薄膜 XRD 测试强度下的半高宽值(FWHM),半高宽值越小,薄膜质量越好, Q_s 值越高, k_t^2 越大。

由于 AlN 具有优良的声学性能和物理性能,如高声速、热导率高、化学稳定性好等,所以我们选用 AlN 作为压电薄膜材料。声学属性为:声速 11 000 m/s,声阻抗 3.7×10^7 kg/m²s,弹性模量 3.95×10^{11} Pa,密度 3 260 kg/m³。因制作 AlN 工艺差异,得到的材料参数可能有差异,所以一般先设计合理的物理尺寸。设计一种 T 为 1 μm, L 为 200 μm, W 为 50 μm 的矩形盘,然后制作器件进行测量,从测量数据中提取准确的材料参数及 k_t^2 和 Q_s 。

2 制备流程

针对给定的物理尺寸,制作了适合工艺的芯片版图,采用半导体工艺结合微机电系统(MEMS)技术,实现了器件的制作,其基本工艺流程如图 4 所示^[6]。

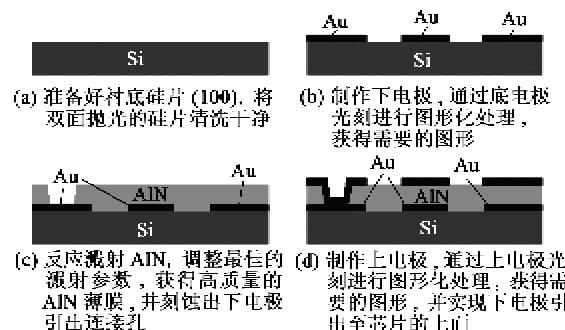




图4 基本流程图

3 实践结果

实际制作的圆片如图5所示：

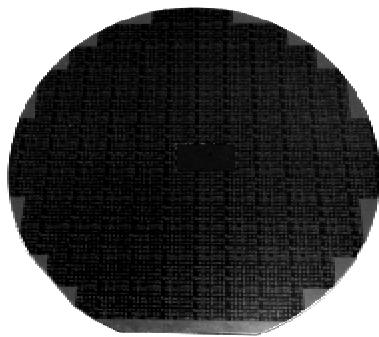


图5 圆片图

通过对器件进行测量和参数的提取^[7]，表1为长度伸缩模式典型的BVD谐振参数。表中， f_s 为串联谐振频率， f_p 为并联谐振频率。

表1 谐振参数

f_s/MHz	19.50	19.40	20.28
f_p/MHz	19.54	19.44	20.33
C_s/pF	0.65	0.53	0.64
L_m/mH	29.107	32.535	19.237
C_m/fF	2.287 5	2.068 0	3.203 0
R_m/Ω	4 460	5 250	3 062

k_t^2 和 Q 值^[2] 分别为

$$k_t^2 = \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{f_p - f_s}{f_p} \right)^2 \quad (6)$$

$$Q_s = \frac{f_s}{2} \left| \frac{d\angle Z}{df} \right|_{f_s} \quad (7)$$

$$Q_p = \frac{f_p}{2} \left| \frac{d\angle Z}{df} \right|_{f_p} \quad (8)$$

式中： Z 为谐振阻抗特性； Q_p 为并联谐振品质因数。

我们希望同时获得高的 k_t^2 和 Q_s ，这样更具应用价值。为此，用优值 $FOM = k_t^2 Q_s$ 表示谐振器的优劣。研制的谐振器约为 0.5%， Q_s 值约 800，FOM 值约为 4，单胞平面尺寸为 $350 \mu\text{m} \times 350 \mu\text{m}$ 。图 6 为实测曲线。

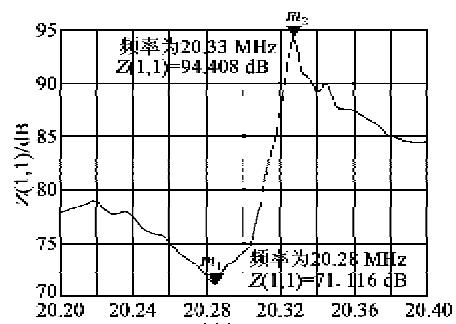


图6 实测曲线

4 结束语

本文阐述了基于AlN轮廓模式盘状谐振器的原理、方法及应用价值。通过一种频率约为 20 MHz 的谐振器的实际制备、测试分析及提取谐振器参数的过程，让我们更深入地掌握了矩形盘谐振器设计特点和制备流程，为进一步应用化的设计提供了实用化分析方法。未来我们的工作将致力于研究如何提高 Q 值和机电耦合系数上，特别是研究制备高质量的 AlN 膜，实现更高性能、更可靠地谐振器，以满足市场需求的小型化谐振、滤波相关产品。

参考文献：

- [1] 金浩.薄膜体声波谐振器(FBAR)技术的若干问题研究[D].杭州:浙江大学,2006.
- [2] 张亚非,陈达.薄膜体声波谐振器的原理、设计与应用[M].上海:上海交通大学出版社,2011.
- [3] RINALDI M, ZUNIGA C, ZUO Chengjie, et al. Super-high-frequency two-port AlN contour mode resonators for RF applications[C]//S. l. : IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2010, 57(1):38-45.
- [4] YAN Le,PANG Wei,EUN S K, et al. Single-chip multiple-frequency VHF low-impedance micro piezoelectric resonators[C]//S. l. : IEEE Electron Device Letters, 2006, 27(14):246-248.
- [5] ZUO Chengjie,SINHA N,PIAZZA G. Very high frequency channel-select MEMS filters based on self-coupled piezoelectric AlN contour-Mod resonators [J]. Sensors and Actuators A, 2010, 160:132-140.
- [6] RINALDI M,ZUNIGA C,PIAZZA G. Ultra-thin-film AlN contour-mode resonators for sensing application [C]//S. l. : 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceeding, 2009:714-717.
- [7] RINALDI M,ZUNIGA C,PIAZZA G. Modify butterworth-van dyke circuit for FBAR resonators and automated measurement system[C]//S. l. : 2000 IEEE Ultrasonics Symposium, 2000:863-868.